

良好な印刷性と優れた溶融特性でボイドを低減

Provide excellent printing properties & very low voiding

EC SOLDER PASTE

BPSシリーズ ~マイクロバンプ用~

インナーバンプとウェハーバンプ向け

特長

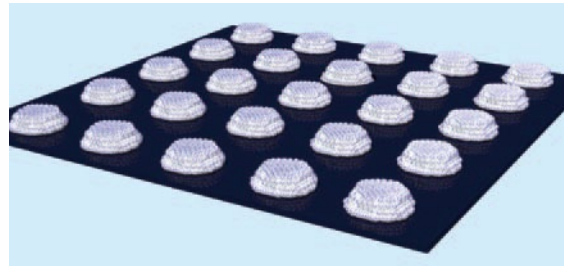
- 溶融性に優れ、ブリッジやはんだボールの発生を抑える。
- 溶融特性に優れ、ボイドの発生を抑える。
- 良好な印刷性を有して、均一なバンプ形成を実現。

製品仕様

□ M705-BPSの使用状態



□ M705-BPSのボイド評価



一定量の印刷でバンプが均一に形成できます。

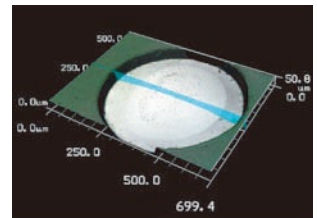
EC SOLDER PASTE

PRCシリーズ ~プリコート用~

半導体パッケージ用途などの狭ピッチに対応

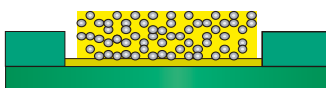
特長

- 印刷性に優れ、薄く均一なはんだ被膜を形成。
- 溶融特性に優れ、不濡れ・ピンホールの防止。



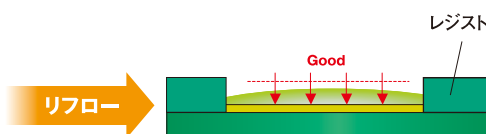
製品仕様

□ 印刷後



プリコート用ペーストを印刷

□ リフロー後



薄く、均一なはんだ被膜の形成

□ 濡れ特性

